

Title (en)

Method of sealing an electrical unit, in particular a relay.

Title (de)

Verfahren zur Abdichtung eines elektrischen Bauelementes, insbesondere eines Relais.

Title (fr)

Procédé d'étanchement d'un élément électrique, en particulier d'un relais.

Publication

EP 0058757 A1 19820901 (DE)

Application

EP 81109139 A 19811028

Priority

DE 3106371 A 19810220

Abstract (en)

[origin: US4427612A] A fleece is employed for the distribution of casting resin over a component surface to be sealed. Prior to the introduction of the casting resin, pressure is applied on the fleece with a heated stamp in order to smoothen the fleece. Through increased temperature of the stamp, or through a solvent, the fleece can be readily cemented together with the component surface. It is thus ensured that the fleece rests uniformly on the entire component surface to promote a favorable distribution of the casting resin.

Abstract (de)

Bei Verwendung eines Vlieses (7) zur Verteilung von Gießharz über eine abzudichtende Bauteiloberfläche wird vor dem Einbringen des Gießharzes mit einem erwärmten Stempel (9) auf das Vlies (7) gedrückt, um dieses zu glätten. Durch erhöhte Temperatur des Stempels (9) oder durch Lösungsmittel kann dabei das Vlies (7) leicht mit der Bauteiloberfläche (2, 3) verklebt werden. Damit wird sichergestellt, daß das Vlies (7) gleichmäßig an der gesamten Bauteiloberfläche anliegt und das Gießharz verteilt.

IPC 1-7

H01H 50/02; H01H 9/04

IPC 8 full level

H01C 17/02 (2006.01); **H01H 9/04** (2006.01); **H01H 49/00** (2006.01); **H01H 50/02** (2006.01); **H01L 23/02** (2006.01)

CPC (source: EP US)

H01H 9/04 (2013.01 - EP US); **H01H 50/023** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [A] DE 2618492 A1 19771110 - SIEMENS AG
- [A] DE 2710211 A1 19780914 - LICENTIA GMBH
- [A] FR 2216752 A1 19740830 - TOKO INC [JP]
- [D] DE 2616299 B1 19770915 - SIEMENS AG

Cited by

EP0351547A3; EP0597279A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE FR GB IT NL SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0058757 A1 19820901; **EP 0058757 B1 19840829**; AT E9190 T1 19840915; BR 8200921 A 19821228; DE 3106371 A1 19820909; DE 3165792 D1 19841004; JP S57152632 A 19820921; PT 74465 A 19820301; PT 74465 B 19830819; US 4427612 A 19840124

DOCDB simple family (application)

EP 81109139 A 19811028; AT 81109139 T 19811028; BR 8200921 A 19820219; DE 3106371 A 19810220; DE 3165792 T 19811028; JP 2369882 A 19820218; PT 7446582 A 19820219; US 33558581 A 19811229